

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

\*最新の特許情報が満載!

## 無電解貴金属メッキ方法と工程

\*\*\*\*\*

[公開編]平成13年~平成14年(2年間) 84点

全文PDF CD-ROM版(抄録版付) ￥16,800-  
 全文紙収録 B5製本版 ￥16,800-  
 (CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ￥25,000-)

### 既刊関連セットのご案内

| No.     | 公開特許 | 既刊関連セットのご案内        | 年次      | 点    | 価格      |
|---------|------|--------------------|---------|------|---------|
| No,9060 | 公開特許 | 無電解貴金属メッキ方法と工程     | 平.11-12 | 65点  | ￥24,200 |
| No,8593 | "    | "                  | 平.9-10  | 62点  | ￥23,700 |
| No,8083 | "    | "                  | 平.7-8   | 66点  | ￥29,500 |
| No,7795 | "    | "                  | 平.5-6   | 63点  | ￥24,700 |
| No,7552 | "    | "                  | 平.3-4   | 57点  | ￥23,000 |
| No,7163 | "    | "                  | 平.1-2   | 61点  | ￥21,000 |
| No,6577 | "    | "                  | 昭.59-63 | 64点  | ￥21,500 |
| No,8537 | "    | 無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成  | 平.7-9   | 65点  | ￥28,000 |
| No,9088 | "    | 硫酸銅メッキ方法と浴の組成      | 平.5-12  | 71点  | ￥27,700 |
| No,9086 | "    | 銅めっき装置の構造と付属装置     | 平.5-12  | 70点  | ￥27,400 |
| No,9087 | "    | プリント基板のメッキ処理装置     | 平.8-12  | 71点  | ￥27,700 |
| No,8929 | "    | メッキ前処理剤の組成と前処理方法   | 平.5-11  | 81点  | ￥31,600 |
| No,8926 | "    | 半田メッキ方法と工程         | 平.5-11  | 75点  | ￥29,700 |
| No,8868 | "    | 半導体ウェーハのメッキ方法と工程   | 平.5-11  | 103点 | ￥35,000 |
| No,9189 | "    | スズ合金メッキ方法と浴の組成     | 平.10-12 | 68点  | ￥24,800 |
| No,9190 | "    | 銀合金メッキ方法と浴の組成      | 平.5-12  | 68点  | ￥24,700 |
| No,9191 | "    | メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法 | 平.9-12  | 60点  | ￥23,200 |
| No,9192 | "    | 抗菌性メッキ加工方法と製品      | 平.9-12  | 57点  | ￥22,800 |
| No,9214 | "    | ハードディスク用基板のメッキ方法   | 平.10-12 | 59点  | ￥20,900 |
| No,9240 | "    | 電解メッキ用給電装置の構造      | 平.5-12  | 103点 | ￥30,000 |
| No,9297 | "    | メタルアレルギー防止メッキ方法    | 平.9-13  | 64点  | ￥16,000 |

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 会社名  | ご注文内容                               |
|      | ニュースガイド No. ,<br>CD-ROM版・B5製本版・一括購入 |
| 所属部署 | 題名                                  |
|      | 合計 ￥                                |
| 担当者名 | E-mail                              |
|      | ( ) Fax ( )                         |
| 住所 〒 |                                     |

# 無電解貴金属メッキ方法と工程

No.9520

[公開編] 平成13年～平成14年(2年間) 84点

CD-ROM版 ¥16,800

B5製本版 ¥16,800

( CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥25,000 )

- |  |                           |   |  |
|--|---------------------------|---|--|
| 1 無電解パラジウム・モリブデン合金めっき液及びめっき方法                      | 日本高純度化学株式会社               | 32 プリント基板の端子部分におけるめっき処理方法及びプリント基板             | 安藤電気株式会社   |
| 2 抗菌性に優れたステンレス鋼材およびその製造方法                          | 川崎製鉄株式会社                  | 33 無電解金めっき液及び無電解金めっき方法                        | 田中貴金属工業株式会社  |
| 3 無電解めっき方法及び無電解めっき液                                | ソニー株式会社                   | 34 無電解多層めっき皮膜が形成された電極及びその製造方法                 | エヌ・イーケムキャット株式会社  |
| 4 白金族金属含有液中からの白金族金属の回収方法                           | 松田産業株式会社                  | 35 貴金属塩で核層形成した支持体、その製造方法およびその使用               | ローベルト ボツシユ ゲゼルシャフト ミット ベシユレンクテル ハフツング<br>アトーテヒ ドイツチュラント<br>ゲゼルシャフト ミット<br>ベシユレンクテル ハフツング |
| 5 貴金属ゾル及びその製造方法                                    | ゴルトシュミット アクチエン<br>ゲゼルシャフト | 36 ゴールド層を生じるための方法と溶液                          | 石原薬品株式会社   |
| 6 銀めっき用アンダーコート剤及びこれを用いた銀めっき製品                      | 久保孝ペイント株式会社               | 37 無電解金メッキ浴                                   | 奥野製薬工業株式会社   |
| 7 白色導電系とその製造方法および装置                                | 三菱マテリアル株式会社               | 38 置換型無電解金めっき方法                               | 上村工業株式会社   |
| 8 はんだボール接続用端子とそのはんだボール接続用端子の形成方法及びそのはんだボール接続端子を... | 日立化成工業株式会社                | 39 無電解金めっき浴                                   | セイコーエプソン株式会社   |
| 9 銀導電膜上への無電解めっき方法                                  | 奥野製薬工業株式会社                | 40 半導体装置及びその製造方法                              | 日立電線株式会社   |
| 10 部分めっきプラスチック成形体の製造方法                             | 日立電線株式会社                  | 41 半導体装置用テープキャリア及びその製造方法                      | 有限会社プロトニクス研究所  |
| 11 ポリイミド樹脂表面への導電性皮膜の形成方法                           | 日本リーロナル株式会社               | 42 複合めっき皮膜                                    | 日立エーアイシー株式会社   |
| 12 金属光沢を有する積層品及びその製造方法                             | 株式会社イノアックコーポレーション         | 43 プリント配線板およびその製造方法                           | 株式会社日鉱マテリアルズ   |
| 13 置換型無電解金めっき液及び無電解金めっき方法                          | 新光電気工業株式会社                | 44 銀めっき前処理剤および銀めっき方法                          | 石原薬品株式会社   |
| 14 ビルドアップ配線板用材料とそのビルドアップ配線板用材料を用いたプリント配線板の製造方法     | 日立化成工業株式会社                | 45 無電解スズ - 銀合金メッキ浴                            | 新光電気工業株式会社   |
| 15 銀 - 錫合金めっき層の形成方法                                | 日本リーロナル株式会社               | 46 電子製品及びその製造方法                               | 日立化成工業株式会社   |
| 16 金メッキシリカ及びその製造方法                                 | 信越化学工業株式会社                | 47 置換金めっき方法                                   | 日立化成工業株式会社   |
| 17 導電性フィルムおよびその作製方法                                | 富士写真フィルム株式会社              | 48 接続端子とその接続端子を用いた半導体パッケージ並びに半導体パッケージの製造方法    | 日立化成工業株式会社   |
| 18 貴金属系触媒除去液                                       | 住友大阪セメント株式会社              | 49 接続端子とその接続端子を用いた半導体パッケージ並びに半導体パッケージの製造方法    | 日立化成工業株式会社   |
| 19 超臨界水酸化分解処理装置の反応容器及び反応容器の製造方法                    | 株式会社フルヤ金属                 | 50 高温及び高電圧下で耐久性のある石英管又は高アルミナ含有管に金被覆する方法、及び... | リウウ・ヒューイ - ターン   |
| 20 誘電体薄膜の形成方法、誘電体薄膜および電子部品                         | 株式会社村田製作所                 | 51 Pd系水素分離膜を製造する方法                            | 三菱重工業株式会社  |
| 21 セラミック配線基板中間体、無電解メッキ方法、およびこれらにより得られるセラミック配線板     | 住友金属鉱山株式会社                | 52 プリント基板                                     | ミツミ電機株式会社  |
| 22 導電性微粒子  | 奥野製薬工業株式会社                | 53 無電解金メッキ方法                                  | 株式会社ミレニアムゲートテクノロジー   |
| 23 三次元成形回路基板の製造方法                                  | 日立電線株式会社                  | 54 無電解白金めっき液の製造方法及び無電解白金めっき液並びに無電解白金めっき方法     | 田中貴金属工業株式会社  |
| 24 導電膜パターン形成方法、及び導電膜パターン                           | セイコーエプソン株式会社              | 55 ULSI用の貴金属薄膜電極の製造方法                         | 田中貴金属工業株式会社  |
| 25 装飾部材  | セイコー株式会社                  | 56 半導体装置およびその製造方法                             | シャープ株式会社   |
| 26 導電性皮膜および導電性皮膜形成用組成物および導電性皮膜形成方法および回路基板          | 株式会社日立製作所                 | 57 接合強度が向上された複合材料およびその形成方法                    | 日本リーロナル株式会社  |
| 27 電磁波シールド層の形成方法                                   | 奥野製薬工業株式会社                | 58 無電解金めっき方法および電子部品                           | 株式会社村田製作所  |
| 28 セラミックヒーター                                       | イビデン株式会社                  | 59 セラミックヒーター                                  | イビデン株式会社   |
| 29 セラミックヒーター及びその製造方法                               | イビデン株式会社                  | 60 銅系材料への置換金めっき方法                             | 奥野製薬工業株式会社   |
| 30 薄膜製造方法及び薄膜白金温度センサの製造方法                          | 株式会社村田製作所                 | 61 銀めっき銅粉の製造方法                                | 日立化成工業株式会社   |
| 31 配線基板およびその製造方法                                   | 京セラ株式会社                   |   | 以下23点省略  |